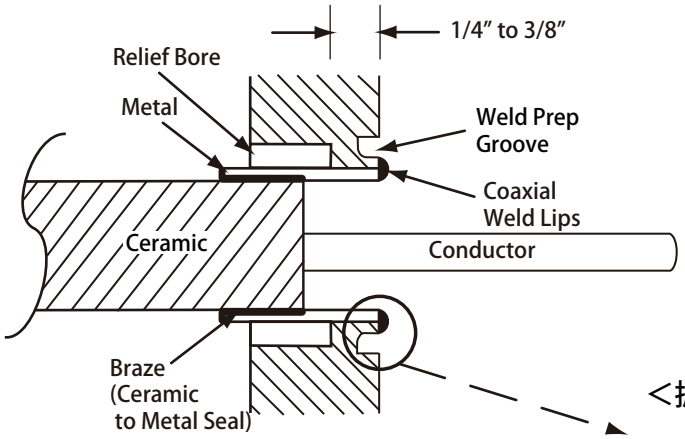
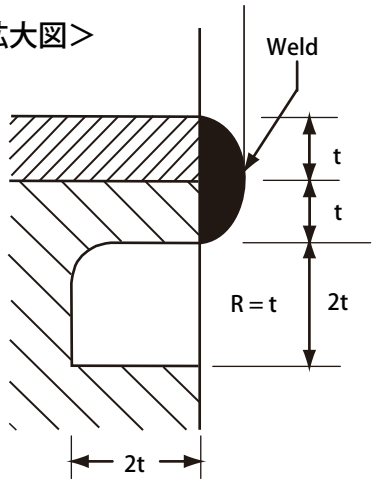
溶接取付について（1）



セラミックグラスシールタイプの製品
（超高真空用 D-Sub コネクタ、A8231 シリーズ）
については<u>レーザー溶接を推奨しております。</u>
Tig 溶接を行う場合は、ヒートシンク対策等を
十分に行って下さい。
<u>また、A11320、A8978(Micro D-Sub) については、
レーザー溶接のみ推奨します。</u>

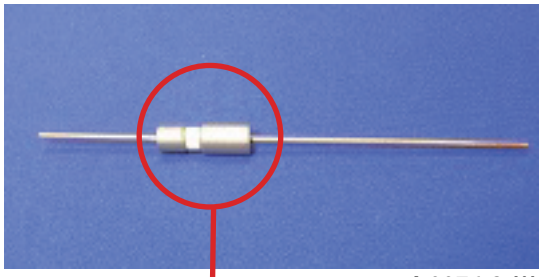
＜拡大図＞



本溶接については、熟練を要します。
溶接取付はロウ付部 (Braze) に、熱がかから
ないように、ヒートシンク対策等を、十分
行って下さい。
<u>溶接取付後の漏れ等については、基本的に
は保証外となります。</u>

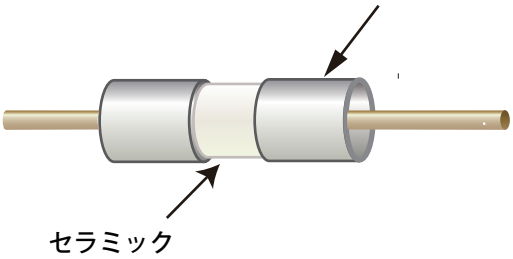
http://tecsam.co.jp　TEL:072-973-4020　FAX:072-973-4032

溶接取付について（2）



A 0076-3-W

＜拡大図＞



ニッケル溶接アダプターの製品について

**※下記型番の製品は、ニッケル溶接アダプターにつき、
Tig 溶接は推奨いたしません。
低温ハンダを推奨いたします。**

A0495-1-W, A0495-2-W, A0495-3-W, A0495-4-W
A0076-1-W, A0076-2-W, A0076-3-W

銅ニッケル溶接アダプターの製品について

**※下記型番の製品は、 銅ニッケルメッキのアダプター
につき、 低温ハンダで取付を行って下さい。
Tig 溶接は不可です。**

A0070-1-W, A0070-2-W, A0070-3-W

http://tecsam.co.jp　TEL:072-973-4020　FAX:072-973-4032